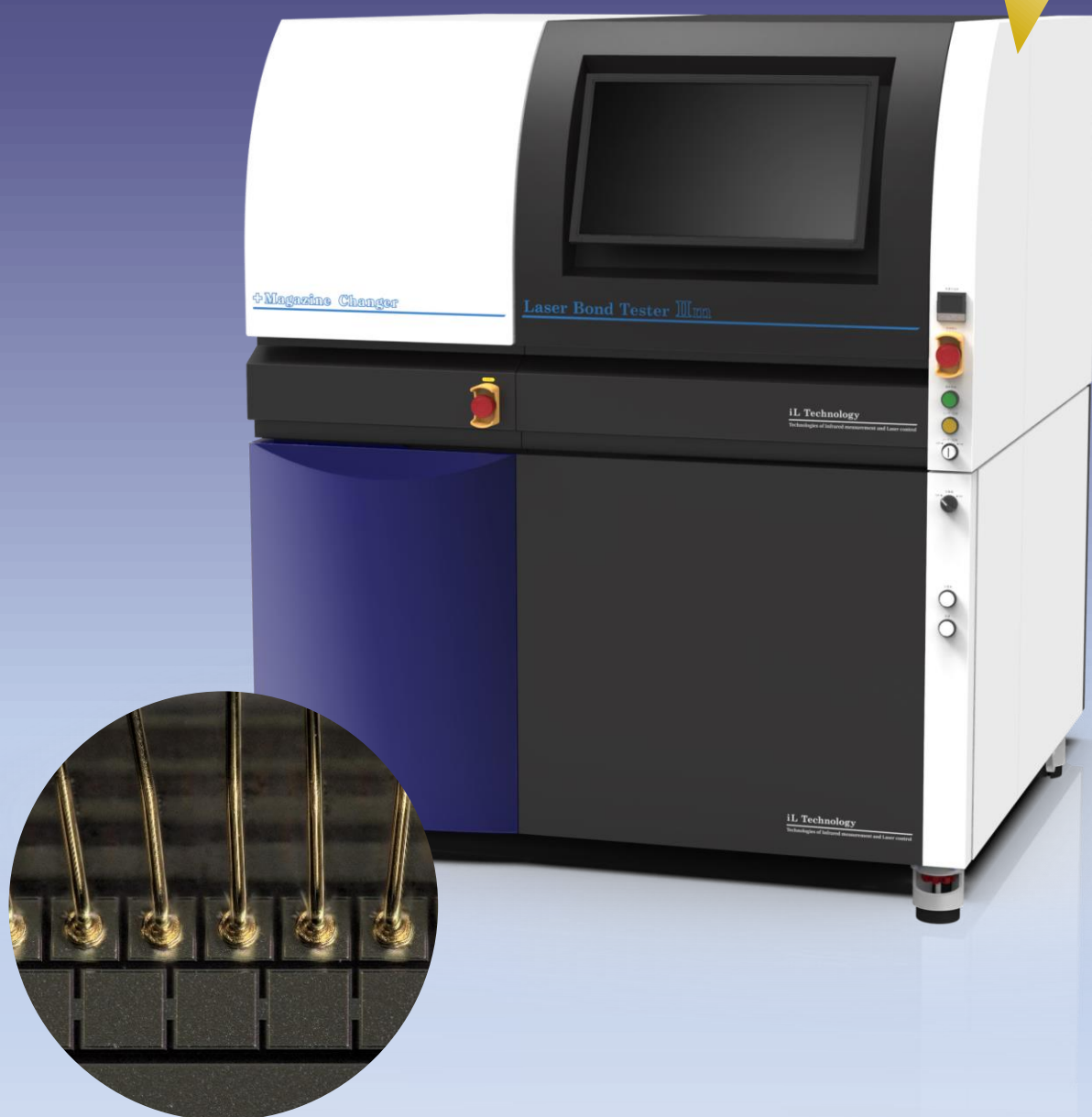


非破壊

レーザーボンドテスター

Laser Bond Tester II + Magazine Changer

業界初！



< 全自動測定 >

金ワイヤボンドの 非破壊 非接触 瞬時測定 を初実用化！

iL Technology

Technologies of Infrared measurement and Laser control

Ver.1.1

概要仕様

測定方法	レーザー周期加熱式接合部位測定法 *3)
測定対象	金/銅 ワイヤ接合部位 *1) ワイヤ径: $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$ *1)
測定値	位相値(接合部位の熱抵抗と強相関)
測定結果表示	位相値・接合面積・接合係数・変換値分布グラフ(下限上限閾値を設定)・ 変換値変位グラフ(測定安定時間を確認)・測定値強度ベクトルグラフ・良否判定
測定結果出力	画面表示及びCSVファイル内容
測定時間	ボンド当たり実質測定時間: 1ms~15ms/ボンド 位置移動時間及び画像処理時間: 0.5~3秒/ボンド
リードフレーム寸法	L: 300mm/max.・W150mm/max.・t: 2mm/max.
マガジン寸法	L: 305mm/max.・W160mm/max.・H: 175mm/max.
マガジnstock数	1個/シングルエレベーター
画像処理機能	最適測定位置認識機能・簡易寸法測定・つぶれ幅測定
レシピ作成	手入力・ティーチング入力・外部作成データ入力(オプション)・座標変換(オプション)
レシピ入力情報	測定位置・測定条件・良否判定
電源	三相AC200V 15A/max.・要接地(D種)
測定用レーザー	半導体レーザー *1) *2)
使用レーザークラス	クラス4: JIS C 6802 / IEC 60825 準拠
装置レーザークラス(通常運用時)	クラス1相当
装置安全基準	ISO13849 / JIS B 9705 準拠
装置本体外形寸法	W:1300mm・D:1300mm・H:1530mm *4) (暫定仕様)
重量	約650kg (暫定仕様)
動作環境	温度: 22~25°C・湿度: 85%RH以下・粉塵無き事

※1) 測定対象毎に測定条件や加熱レーザーの調整などが必要です。

※2) 本装置のレーザーはクラス4製品です。ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けて下さい。

※3) 測定方法は、株式会社ジェイテクトのpatentに基づいています。

※4) 外形寸法は突起部を含みません。筐体部分のみの寸法で、上部のパトライト寸法などは含まれていません。

※5) 本装置は温度調整ユニット用に工業用純水が必要です。(内部循環式)

※6) 本装置は機能・性能向上の為、お断りなく仕様変更される場合があります。

※7) “レーザーボンドテスター”及び“Laser Bond Tester”は、アイエルテクノロジー株式会社の登録商標です。



製造元

iL Technology Corporation

アイエルテクノロジー株式会社

愛知県岡崎市針崎1丁目1番地13

TEL: 0564-73-2005

URL: <http://www.il-tech.jp>

販売代理店



株式会社 南陽

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号

TEL: 092-473-7711

URL: <https://www.nanyo.co.jp>